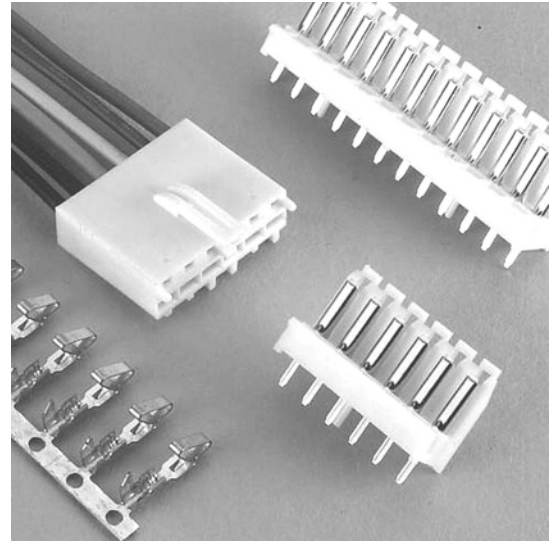


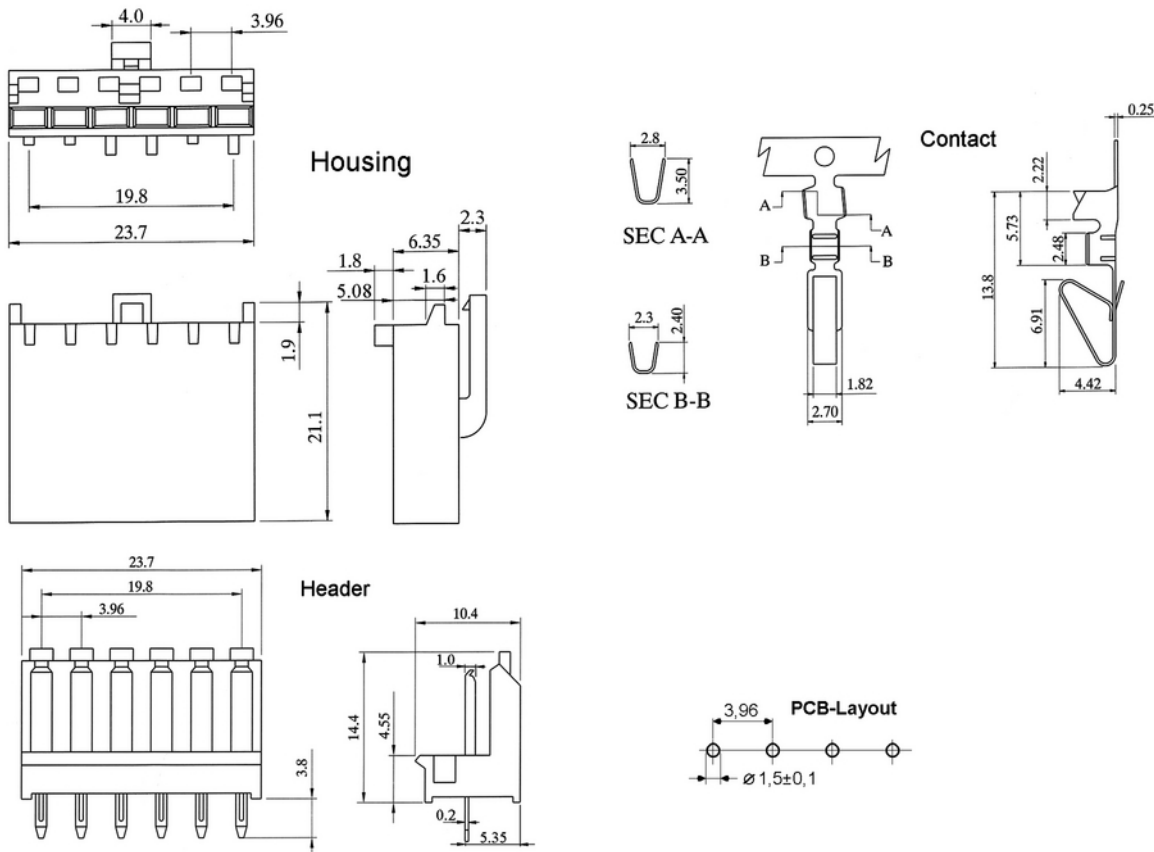
Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 3,96mm, gerade Friction Lock Headers / Crimp Housings, 3.96mm Pitch, Straight

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Aderquerschnitt	AWG 18 ... 24
Applicable wire Gauge	AWG 18 ... 24
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1,5kV _{AC}
Test Voltage	1.5kV _{AC}
Nennspannung	250V _{AC}
Voltage Rating	250V _{AC}
Nennstrom	5A
Current Rating	5A
Temperaturbereich	-25°C ... +85°C
Temperature Range	-25°C ... +85°C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering



© W+P PRODUCTS



Series	Contacts*	Type*	Plating
536	06	3	50
	06/12 01 (Für Buchsenkontakte) (For crimp contacts)	1 Buchsengehäuse Housings 2 Buchsenkontakte Crimp contacts 3 Stiftleisten gerade Pin headers, straight	50 Verzinkt (für Gehäuse nicht erforderlich) Tin plated (not used for housings)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-20

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wpro.com
WEBSITE www.wpro.com

Informationen zum Wellen-Lötverfahren Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:

